

各 位

2026年9月7日

会 社 名 株式会社メガチップス
代 表 者 名 代表取締役社長 肥川 哲士
(コード番号 6875 東証プライム)
問い合わせ先 経営企画室 三宅 正久
(TEL 06-6399-2884)

次世代ASIC・LSI設計におけるMegaChipsとproteanTecsの協業について ～量産から実稼働まで、半導体の可視性・信頼性・性能を向上～

株式会社メガチップス（本社：大阪市淀川区、以下「メガチップス」という）は、先進エレクトロニクス向けのヘルス・性能管理ソリューションを提供する proteanTecs Ltd.（以下「proteanTecs」という）と協業し、proteanTecs が保有するインチップモニタリングおよびディープデータ解析技術を、メガチップスの次世代 ASIC・LSI 設計に活用していきます。

本協業を通じて、両社は、AI および高性能電子システムに使用される先進的な ASIC・LSI 設計において「deep silicon visibility（シリコン内部の深い可視性）」を実現し、開発・量産から実運用まで、製品ライフサイクル全体にわたる半導体の挙動に関する詳細な知見を提供できるようにします。

量産時には、インチップモニタから取得したデータにより、シリコンの健全性や性能に関する情報を提供し、歩留まりの最適化、品質向上、信頼性向上を支援します。また、実稼働時には、継続的なモニタリングおよび解析機能により、実際の負荷や動作条件下におけるデバイスの挙動をリアルタイムで可視化し、電力・性能の管理、信頼性のモニタリング、潜在的な信頼性に関わる問題の早期発見を支援します。

proteanTecs のインチップモニタリングおよびデータ解析技術と、メガチップスが培ってきた ASIC・LSI 設計の知見を融合させることで、両社は製品ライフサイクル全体にわたって、顧客に実用的なシリコン情報を提供します。また、量産立ち上げ期間の短縮、電力・性能の管理、信頼性の向上、実運用時におけるデバイスの挙動の可視化を支援します。

AI、エッジコンピューティング、データセンター、先進通信などの成長市場では、半導体デバイスに対して、より高い性能、電力効率、熱管理、圧倒的な信頼性が求められています。同時に、半導体デバイスの微細化や設計の複雑化が進む中、量産時および実運用時における実際のシリコンの「ブラックボックス化」や、実稼働時における「サイレント・データ・コリプション（SDC）」といった前例のない課題に業界は直面しています。これらの課題を克服するためには、全ライフサイクルを通じて実際のハードウェア挙動を理解するディープ・シリコン・ビジビリティが不可欠となっています。

メガチップスが長年培ってきた ASIC・LSI 設計の知見および Design-for-Test (DFT) 技術と、proteanTecs のインチップモニタリングおよびデータ解析技術を組み合わせることで、従来の DFT フローに変革をもたらし、顧客の開発・量産におけるリスクの低減、開発期間の短縮、製品信頼性の向上、電力・性能の最適化を支援します。

本協業を通じて、両社は AI 半導体や Co-Packaged Optics (CPO) を含む次世代 ASIC・LSI 設計ソリューションを進化させ、製造から実稼働に至る全ライフサイクルでデバイスの健全性と性能をより的確に把握・管理・最適化できるよう顧客をサポートし、成長市場におけるアプリケーションに貢献してまいります。

株式会社メガチップスについて

株式会社メガチップスは、1990 年に日本初のファブレス LSI 企業として設立され、アナログ技術とデジタル技術を融合した革新的な半導体ソリューションを開発しています。

長年にわたり培ってきた LSI 設計の豊富な知見を基盤に、ASIC、ASSP、モジュールソリューションなど幅広いソリューションを提供し、設計から製造まで、グローバル市場における顧客の多様なニーズに対応しています。

ウェブサイト：www.megachips.co.jp

以 上